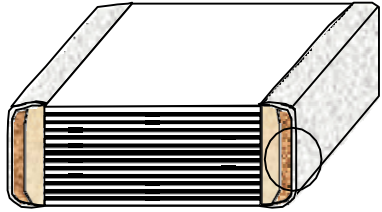
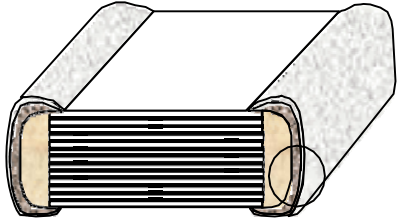
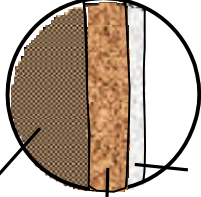
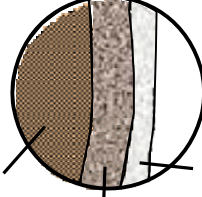


# 新電極(X)品電極構造比較

## 1. 電極構造比較

| ECHU(B)・ECWU(B)  | ECHU(X)・ECWU(X)   |
|--|---|
|   |   |
| <p>1. 第1層：真鍮<br/>2. 第2層：燐青銅系合金<br/>3. 第3層：はんだメッキ</p> <p>&lt;外部電極構造&gt;</p>  <p>1. 第1層      2. 第2層      3. 第3層</p> | <p>1. 第1層：真鍮<br/>2. 第2層：導電性ペースト<br/>3. 第3層：はんだメッキ</p> <p>&lt;外部電極構造&gt;</p>  <p>1. 第1層      2. 第2層      3. 第3層</p> |

## 2. 比較試験結果

### 2-1) リフローはんだ付け性

(不良数/試験数)

| 項目              | 両側実装   | 片側実装※  |
|-----------------|--------|--------|
| ECHU(B)・ECWU(B) | 5/1008 | 14/105 |
| ECHU(X)・ECWU(X) | 0/1008 | 0/105  |

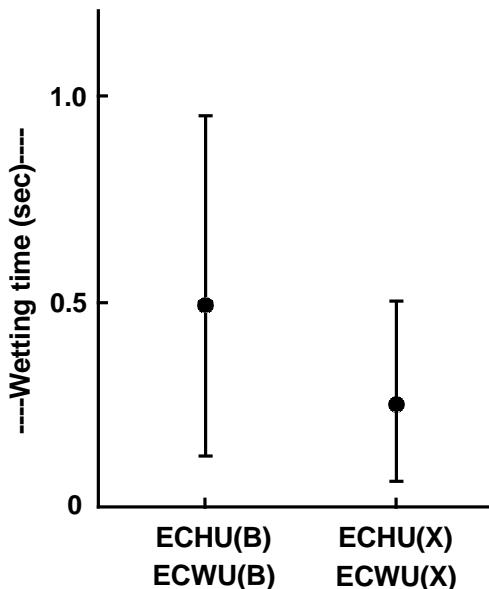
<はんだ付け条件>

クリームはんだ厚み：0.15 μm

リフロー温度：素子表面最高到達温度 210°C

※片側実装 電極片側のランドにはクリームはんだを塗らないでもう一方の電極でのみ実装を行う試験

### 2-2) 濡れ性試験（メニスコグラフ法）



### 2-3) 外部電極はんだメッキ厚み

